



2024年3月期 第1四半期

(2023年4月1日 ~ 2023年6月30日)

決算補足資料

ENOMOTO Co.,Ltd.

東証プライム 証券コード:6928

- 円安が増収要因となったものの、中国経済の停滞及び欧米のインフレによる世界的な個人消費の低迷から民生用機器を中心に在庫調整が継続し、減収減益
- 前期4Q比では底打ちしたものの、ほぼ横ばいで推移

	2023/3期 1Q		2024/3期 1Q		期比較	
	実績(百万円)	売上比(%)	実績(百万円)	売上比(%)	前年同期比(%)	売上比増減(pt)
売上高	7,243	100.0	6,426	100.0	△11.3	-
売上総利益	1,155	16.0	722	11.2	△37.5	△4.7
販管費	619	8.5	590	9.2	△4.7	+0.6
営業利益	536	7.4	132	2.1	△75.3	△5.3
為替差損益	84	1.2	12	0.2	△85.4	△1.0
経常利益	638	8.8	162	2.5	△74.5	△6.3
四半期純利益	431	6.0	96	1.5	△77.5	△4.5
1株当たり 四半期純利益	64.66円	-	14.52円	-		

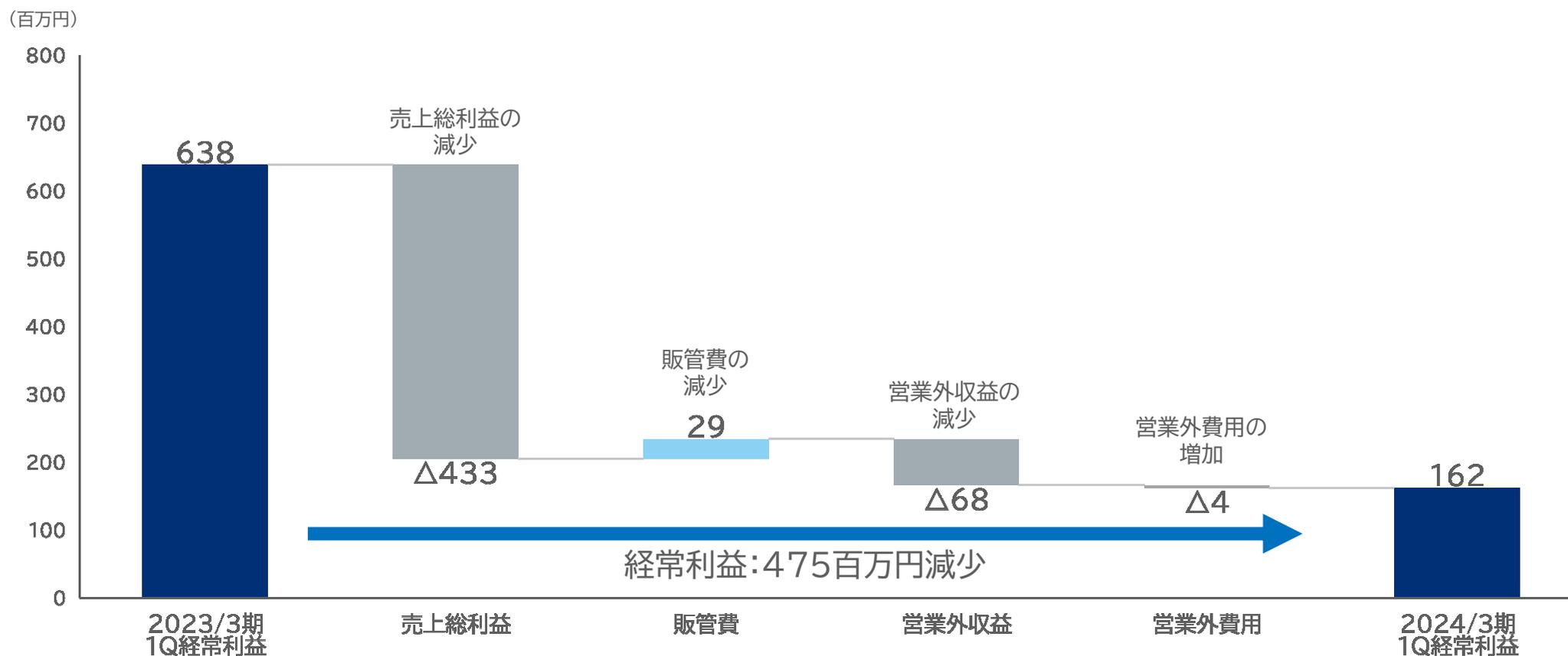
- ・ 車載は全体としては横ばいで推移しながらも、製品や向け先によってまだら模様
- ・ 前4Qから在庫調整は継続、スマートフォン向け新規モデルの量産開始により利益面は若干上向いた

単位:百万円	2023/3期					2024/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前4Q比
売上高	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	△2.2
売上総利益	1,155	1,017	1,231	695	4,100	722	+3.9
販管費	619	615	655	648	2,538	590	△9.1
営業利益	536	401	575	46	1,561	132	+183.7
為替差損益	84	53	△80	△20	37	12	-
経常利益	638	489	516	161	1,805	162	+0.6
四半期純利益	431	346	433	57	1,269	96	+69.6

- ・ パワー半導体用リードフレームの車載向けは横ばい、民生・産機向けは調整局面
- ・ オプト用リードフレームは海外の交通インフラ向けや大型ディスプレイ向けなどが販売低迷
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン(旧モデル)向け及びウェアラブル端末向けの在庫調整が継続

単位:百万円	2023/3期					2024/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前年同期比
パワー半導体用 リードフレーム	2,684	2,797	3,377	3,113	11,973	3,164	+17.9%
オプト用 リードフレーム	1,008	931	854	925	3,719	712	△29.4%
コネクタ用部品	3,408	3,496	3,627	2,379	12,912	2,437	△28.5%
その他	143	180	180	155	659	112	△21.7%
合計	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	△11.3%

- 売上総利益の減少 … ① スマートフォン・ウェアラブルを含む民生機器向けを中心とした在庫調整による売上減少
② 主にウェアラブル向けの減少による製品ミックス変動から、付加価値率低下
③ 電力費や労務費等の準変動費は、工場稼働率の低下に伴い減少
- 販売管理費の減少 … 出荷減少に伴う運賃搬送費・梱包費の減少
- 営業外収益の減少 … 前期は助成金収入を計上



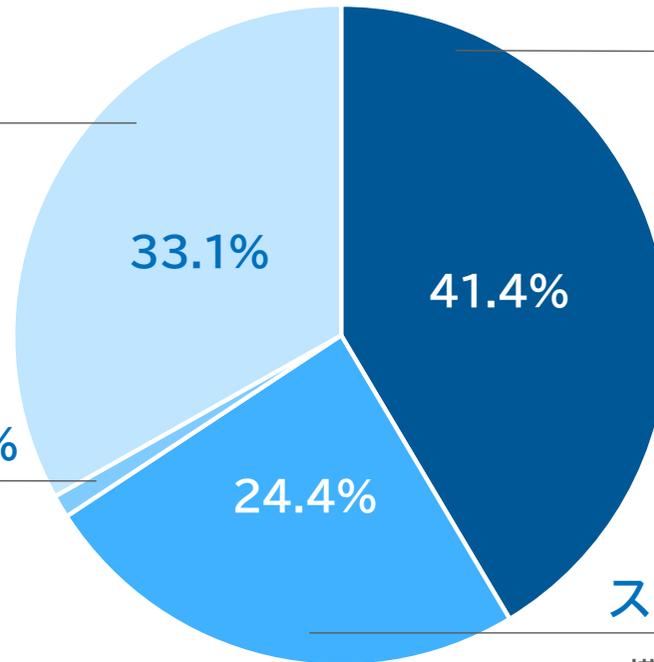
- 車載(特に xEV向け)は、ほぼ横ばいで推移
- スマートフォン向けの足下の出荷は新規モデルにシフト、第2～3四半期に掛けて出荷が増加する見通し
- ウェアラブル向けは調整が継続、回復は下期以降を見込む

民生・産機・その他

- 構成比は前年同期の34.4%から 1.3pt減少
前期比20.7%減少
- 交通インフラ等のディスプレイ向けLED用
リードフレームが減速

ウェアラブル

- 構成比は前年同期の4.9%から 3.8pt減少
前期比81.1%減少
- 調整が継続、回復は下期以降を見込む



車載

- 構成比は前年同期の33.5%から 7.9pt増加
前期比2.1%増加
- xEV向けパワー半導体用リードフレームは好調維持
- 生産調整影響でエアバッグ用コネクタ等が減少

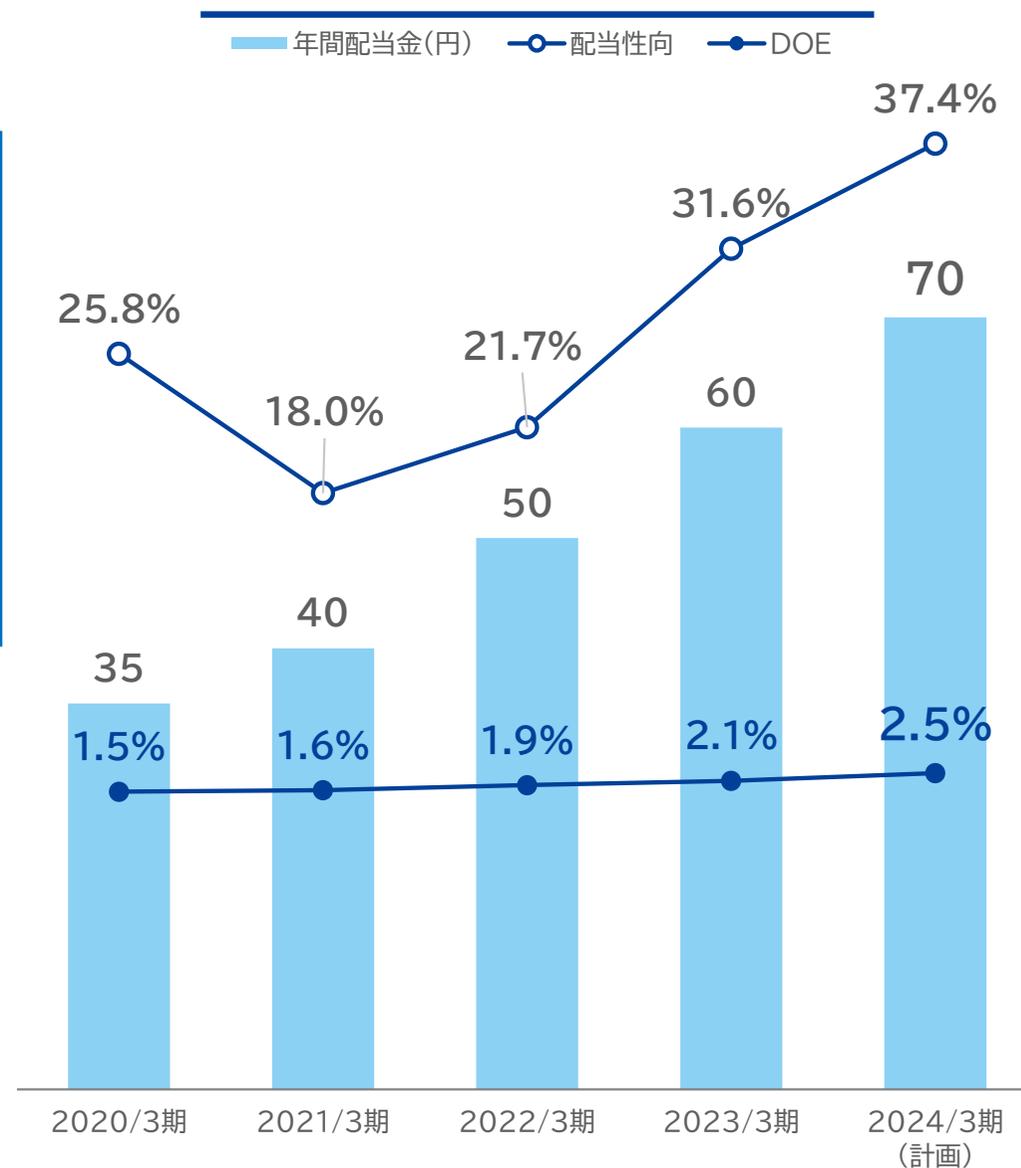
スマートフォン

- 構成比は前年同期の27.2%から 2.8pt減少
前期比26.3%減少
- スマートフォンの生産調整の影響
- 新規モデルの生産が第2四半期から回復基調に

- ・ クリップボンディングタイプをはじめ、パワー半導体用リードフレームは横ばい
- ・ スマートフォン、ウェアラブル向けマイクロコネクタ用部品は、下期以降に回復を見込む
- ・ 不透明な市場動向を注視…予想据置き

	2023/3期実績		2024/3期予想		期比較	
	実績(百万円)	売上比(%)	予想(百万円)	売上比(%)	前年比(%)	売上比増減(pt)
売上高	29,265	100.0	29,000	100.0	△0.9	-
売上総利益	4,100	14.0	4,300	14.8	+4.9	+0.8
販管費	2,538	8.7	2,600	9.0	+2.4	+0.3
営業利益	1,561	5.3	1,700	5.9	+8.9	+0.5
経常利益	1,805	6.2	1,700	5.9	△5.9	△0.3
当期純利益	1,269	4.3	1,250	4.3	△1.5	△0.0
1株当たり純利益	190.0円	-	187.1円	-	-	-

配当金・配当性向の推移



2024年3月期以降の配当方針

- DOE*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 次期中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2024年3月期は**70円配当**を予想 (DOE2.5%)

* DOE(自己資本配当率)=年間配当額 / 株主資本

- 2024年3月期は中長期的な成長に向けた仕込み期間と位置付け
2026年3月期以降に「1st STEP」数値目標達成を目指す
- 先行指標となる金型受注は非常に旺盛であり、生産調整後の需要回復に大きな期待

<p>パワー半導体用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 拡大が予測されているパワー半導体市場に向けクリップボンディング式リードフレームを拡販 ⇒ 中国に加え日本・フィリピンにおいても量産本格化
<p>オプト用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 車載/民生向け部品のLED用リードフレーム受注増に対する、増産体制確立
<p>コネクタ用部品</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5G/6Gに向け、高周波対応のマイクロコネクタによる更なるシェアアップ • 中長期的な成長が見込まれるウェアラブル市場へのマイクロコネクタ拡販
<p>メッキライン(内製化)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 中国メッキ新工場、津軽工場新メッキラインの量産効果による付加価値率の更なる向上

注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。